



鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

H1000-Soft 超软系列

【导热硅胶垫片】规格书



- 产品图 -

鸿富诚 H1000-Soft 导热硅胶垫片，是一款压缩应力低的热界面材料。产品具有很好的电气绝缘特性和稳定性，防火性能高，产品表面有自然粘性，能够很好地填充间隙，实现发热部件到散热部件之间的热传递。产品极具工艺性和使用性，是一种极佳的导热填充材料，被广泛应用于电子元器件产品中。

应用特点：

- 可压缩性好
- 热阻抗较小
- 表面自带粘性
- 防火性能高
- 低压力下应用
- 很好的电绝缘性能

应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

储存条件：阴暗处储存

储存温度： $\leq 30^{\circ}\text{C}$

储存湿度： $\leq 70\%$

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：2年

不符合储存条件下：6个月

产品性能

NO.	参数	单位	测试方法
颜色	灰色	---	目视
厚度	1~3	mm	ASTM D 374
硬度	30(± 5)	Shore 00	ASTM D 2240
密度	3.60(± 0.5)	g/cc	ASTM D 792
压缩比	≥ 50 (@30psi)	%	ASTM D 695
出油率	≤ 1	%	---
阻燃等级	V-0	---	UL-94
使用温度	-40~125	$^{\circ}\text{C}$	IEC 60068-2-14

热学特性

导热系数	10.0(± 0.5)	W/m·K	ASTM D 5470
热阻	≤ 0.38 (@10Psi/2mm)	$^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$	ASTM D 5470

电学特性

击穿电压	≥ 5	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	$\geq 10^8$	$\Omega \cdot \text{cm}$	ASTM D 257
介电常数	≥ 2	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	≤ 0.1	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权

